

Übersicht Warengliederung

1	Materialien	4	Inspektions- und Testsysteme
2	Herstellungsverfahren und -technik	5	Bauelemente/Geräte
3	Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration	6	Anwendungen
		7	Dienstleistungen und Services

Warengliederung

- | | |
|--|---|
| <p>1 Materialien</p> <p>1.1 Substrate</p> <p>☐ 1.1.1 Plastikfolien</p> <p>☐ 1.1.2 Metallfolien</p> <p>☐ 1.1.3 Papier</p> <p>☐ 1.1.4 Glas</p> <p>☐ 1.1.5 Textilien</p> <p>☐ 1.1.6 Sonstige Substrate</p> <p>1.2 Leitende Materialien</p> <p>☐ 1.2.1 Organische Leiter</p> <p>☐ 1.2.2 Anorganische Leiter</p> <p>☐ 1.2.3 Nanomaterialien</p> <p>☐ 1.2.4 Carbon Nanotubes</p> <p>☐ 1.2.5 Graphen</p> <p>☐ 1.2.6 Hybride Leiter</p> <p>1.3 Halbleiter</p> <p>☐ 1.3.1 Polymere Halbleiter</p> <p>☐ 1.3.2 Halbleiter (kleine Moleküle)</p> <p>☐ 1.3.3 Anorganische Halbleiter</p> <p>☐ 1.3.4 Nano Halbleiter</p> <p>☐ 1.3.5 Carbon Nanotubes (Halbleiter)</p> <p>☐ 1.3.6 Hybride Halbleiter</p> <p>1.4 Dielektrika</p> <p>☐ 1.4.1 Organische Dielektrika</p> <p>☐ 1.4.2 Anorganische Dielektrika</p> <p>☐ 1.4.3 Nanomaterialien</p> <p>☐ 1.4.4 Hybride Dielektrika</p> <p>1.5 Verkapselungsmaterialien und Kleber</p> <p>☐ 1.5.1 Dünnschichtverkapselung</p> <p>☐ 1.5.2 Polymerverkapselung</p> <p>☐ 1.5.3 Metallverkapselung</p> <p>☐ 1.5.4 Glasverkapselung</p> <p>☐ 1.5.5 Kleber</p> <p>☐ 1.6 Sonstige Materialien</p> <p>2 Herstellungsverfahren und -technik</p> <p>2.1 Massendruckverfahren</p> <p>☐ 2.1.1 Tiefdruck</p> <p>☐ 2.1.2 Offsetdruck</p> <p>☐ 2.1.3 Flexodruck</p> <p>☐ 2.1.4 Siebdruck</p> <p>☐ 2.1.5 Sonstige Massendruckverfahren</p> | <p>2.2 Digitale Druckverfahren</p> <p>☐ 2.2.1 Inkjetdruck</p> <p>☐ 2.2.2 Sonstige digitale Druckverfahren</p> <p>2.3 Sonstige Druckverfahren</p> <p>☐ 2.3.1 Mikrokontaktdruck</p> <p>☐ 2.3.2 Nano imprint</p> <p>2.4 Vakuumprozesse</p> <p>☐ 2.4.1 Aufdampfverfahren</p> <p>☐ 2.4.2 Sputtering</p> <p>☐ 2.4.3 Organic vapor phase deposition (OVPD)</p> <p>☐ 2.4.4 Sonstige Vakuumprozesse</p> <p>☐ 2.5 Fotolithografie</p> <p>2.6 Laserverfahren</p> <p>☐ 2.6.1 Laserablation</p> <p>☐ 2.6.2 Lasertransfer</p> <p>2.7 Beschichtungsverfahren</p> <p>☐ 2.7.1 Rotationsbeschichtung (Spin coating)</p> <p>☐ 2.7.2 Tauchbeschichtung (Dip coating)</p> <p>☐ 2.7.3 Rakelbeschichtung (Blade coating)</p> <p>☐ 2.7.4 Sonstige Beschichtungsverfahren</p> <p>2.8 Materialverarbeitung</p> <p>☐ 2.8.1 Dispergiertechnik</p> <p>☐ 2.8.2 Sonstige Materialverarbeitung</p> <p>2.9 Photoinduzierte Prozessierung</p> <p>☐ 2.9.1 IR Trocknungsverfahren</p> <p>☐ 2.9.2 UV Verfahren</p> <p>☐ 2.9.3 Laserverfahren</p> <p>2.10 Dosier- und Mischtechnik</p> <p>☐ 2.10.1 Pumpen</p> <p>☐ 2.10.2 Sonstige Dosier- und Mischtechniken</p> <p>2.11 Verkapselungstechnik</p> <p>☐ 2.11.1 Dünnschichtverkapselung</p> <p>☐ 2.11.2 Polymerverkapselung</p> <p>☐ 2.11.3 Metallverkapselung</p> <p>☐ 2.11.4 Glasverkapselung</p> <p>☐ 2.11.5 Sonstige Verkapselungstechniken</p> <p>☐ 2.12 Reinraumtechnik</p> <p>☐ 2.13 Rolle-zu-Rolle-Verfahren</p> <p>☐ 2.14 Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken</p> |
|--|---|

Warengliederung

info@lopec.com, Tel. +49 89 949-20364

Messe München GmbH, Am Messesee 2, 81829 München, Deutschland

3 Elektronikfertigung, Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration

- 3.1 Elektrische Verbindungstechnik
 - ☐ 3.1.1 Flip Chip
 - ☐ 3.1.2 Sonstige Verbindungstechniken
- ☐ 3.2 Laminierung
- ☐ 3.3 Systemintegration
- ☐ 3.4 Hybride Systeme (Polytronik)

4 Inspektions- und Testsysteme

- ☐ 4.1 Elektrische Charakterisierung
- ☐ 4.2 Physikalische/Optische Charakterisierung
- ☐ 4.3 Chemische Charakterisierung
- ☐ 4.4 Simulation/SchaltkreISOptimierung
- ☐ 4.5 Lebensdauertest
- ☐ 4.6 Qualitäts-/Prozesskontrolle
- ☐ 4.7 Umweltprüfverfahren
- ☐ 4.8 Sonstige Inspektions- und Testsysteme

5 Bauelemente/Geräte

- ☐ 5.1 Transistoren
- ☐ 5.2 Dioden
- 5.3 Passive Bauelemente
 - ☐ 5.3.1 Kondensatoren
 - ☐ 5.3.2 Widerstände
 - ☐ 5.3.3 Sonstige passive Bauelemente
- ☐ 5.4 Integrierte Schaltkreise
- 5.5 Displays
 - ☐ 5.5.1 OLED
 - ☐ 5.5.2 Elektrophoretische Displays
 - ☐ 5.5.3 Elektrochrome Displays
 - ☐ 5.5.4 Elektrolumineszenz-Displays
 - ☐ 5.5.5 LCD
 - ☐ 5.5.6 Electrowetting
 - ☐ 5.5.7 Sonstige Displays
- 5.6 Photovoltaikzellen
 - ☐ 5.6.1 Organische Photovoltaikzellen
 - ☐ 5.6.2 Hybride Photovoltaikzellen
 - ☐ 5.6.3 Anorganische Photovoltaikzellen

5.7 Sensoren

- ☐ 5.7.1 Fotodioden
- ☐ 5.7.2 Drucksensoren
- ☐ 5.7.3 Temperatursensoren
- ☐ 5.7.4 Biomedizinische Sensoren
- ☐ 5.7.5 Gassensoren
- ☐ 5.7.6 Berührungssensoren
- ☐ 5.7.7 Sonstige Sensoren
- ☐ 5.8 Speicherbausteine
- ☐ 5.9 Antennen
- ☐ 5.10 Batterien
- ☐ 5.11 Komponenten für hybride Systeme
- ☐ 5.12 Sonstige Bauelemente

6 Anwendungen

- ☐ 6.1 TFT Backplanes
- ☐ 6.2 Displays
- ☐ 6.3 Sensoren
- ☐ 6.4 Intelligente Systeme
- ☐ 6.5 RFID
- ☐ 6.6 Solarzellen
- ☐ 6.7 Intelligente Textilien
- ☐ 6.8 Lautsprecher
- ☐ 6.9 Beleuchtung
- ☐ 6.10 Sonstige Anwendungen

7 Dienstleistungen und Services

- ☐ 7.1 Consulting
- ☐ 7.2 F&E Förderprogrammmanagement
- ☐ 7.3 F&E/Forschung & Entwicklung
- ☐ 7.4 Prototypenentwicklung
- ☐ 7.5 Auftragsfertigung
- ☐ 7.6 Kapital- und Risikobeteiligungsformen
- ☐ 7.7 Fachvereinigungen und -verbände
- ☐ 7.8 Fachbücher, Fachzeitschriften, Fachverlage
- ☐ 7.9 Sonstige Dienstleistungen